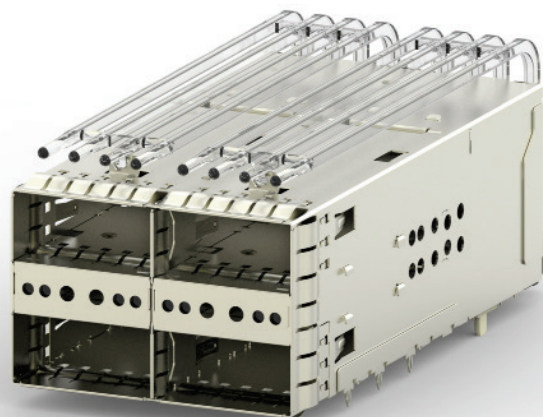


## 製品紹介

# ZQSFP+両面基板接続 ケージ

- シングルPCBアーキテクチャを適用することにより、システム設計コストを削減
- 次世代48及び64シリコンポートの使用により高密度なスイッチ設計を実現



統合コネクタを備えたzQSFP+両面基板接続ケージは、オープンコンピュータプロジェクト（OCP）基準設計に基づき、次世代48及び64シリコンポートを使用することにより、高密度スイッチ及びNIC設計要件に対応しています。両面基板接続ケージは、ラインカードごとにシングルPCBアーキテクチャを採用しているため、PCBが2つの場合と比べ大幅にコストを削減できます。他のzQSFP+ポートフォリオと同様に、これらのケージおよびコネクタは、より高速なシステムスピードを実現するため、最大28G NRZおよび56G PAM-4データレートに対応しております。

### 主な特長

- 両面基板接続設計が、ラインカード1枚につきシングルPCBアーキテクチャを可能にし、大幅なコスト削減を実現
- オープンコンピュータプロジェクト（OCP）基準設計の他に、次世代48及び64シリコンポートを使用することで高密度スイッチ設計をサポート
- 28Gbps以上のデータレートで4チャンネル（4x）を提供
- 100 Gbpsイーサネット（28 Gbps×4）および100 Gbps InfiniBand（IB）拡張版データ通信速度仕様（EDR）要件に対応
- 相当な電氣的マージンにより現行の10 Gbpsおよび16 Gbpsアプリケーションでも使用可能
- 既存のQSFP光モジュールおよびケーブルアセンブリとの下位互換性
- 56 Gbps PAM-4技術に対応
- Molexとのデュアルソースおよび完全互換性

### さらに詳しく

[zQSFP+ランディングページ](#)

[zQSFP+クイックレファレンスガイド](#)

[zQSFP+部品リスト](#)

TE Connectivity、TE、TE Connectivity（マーク）は商標です。  
zQSFP+は、ZXP@コネクタファミリーの一部であり、ZXP技術を採用しています。ZXPは、Molex LLCの商標です

### 用途

- スイッチ
- NICカード

### 電気特性

- シールドおよび信号接点用のローレベル接触抵抗（LLCR）：
  - 初期（ベースライン）からの上昇値  
10 mΩ最大
- 絶縁抵抗：最小1000 MΩ

### 機械特性

- トランシーバの嵌合力：最大40 N
- トランシーバ抜去力：最小30 N
- プレスフィット挿入力：
  - ケージピン当たり最大40 N
  - コネクタピン当たり：最大20 N
- ケージのラッチ、軸方向保持：最小125N

### 材料

- ケージ：洋白

**KYORITSU**  
**協立電業株式会社**

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5  
TEL: 042-548-8881 (代)  
FAX: 042-548-9101 (代)

**TE**  
connectivity